Application for Temporary Leave of Absence

No.

日(願出) Day (Submitted)

(印)

Seal

(EII) Seal

日

日

Day

受けていない

Have never used it

利用した事がない

Not receiving any scholarships

)

まで

月

Month

学籍番号

Student ID Number

年

Year

太線 本 学部 学 科 専 攻 年 組 学 Faculty Major Year Department Class \mathcal{O} 本 研究科 修士・博士・専門職学位 課程 保 Student Information 際 車 攻 年 Master's / Doctoral / Professional Degree 内 証 は Major Year Program 人 就 4 そ フリガナ 学 れぞれ自 消えない 届 氏 名 を Name 提 メールアドレス 出 TEL 現住所 ペンで記入してください 署 E-mail address L てくだ Current 押 Address 印 z ガ ナ してくださ uarantor Information 保 氏 名 Name 証 現住所 TEL Current Address 下記理由のため休学したくお願いいたします。 I would like to apply for a temporary leave of absence for the following reason. Both student and guarantor must stamp their own seal or sign their signature. チェックボックス(一箇所のみ)に 🗸 点を入れ、必要事項を記入してください。 Please check the box which applies to you and provide the required information. □ 語学研修 *入学許可書の写しを添付してください。 For language training when returning to Keio. *Please attach a copy of your acceptance letter. Reason for Temporary Leave of Absence 留 For study abroad 大学名·研修先 Name of university/institution: Notes: 1. Fill out the part inside the bold lines using an indelible pen. 所在国·都市 Location (City/Country) Period 学 単位取得予定 Do you plan to obtain credits?: なし No □ 正課または課外活動中の事故による傷害のため Submit a Notification of Returning to Study Due to an injury sustained in an accident 理 during a curricular or extracurricular activity *医師の診断書を添付してください。 □ 病気療養のため *Please attach a medical certificate filled out by a medical professional. For medical treatment □ 怪我のため Due to an injury □ 母国における兵役義務のため *兵役義務証明書を添付してください(和訳または英訳添付)。 Due to military duty in the home country *Please attach a certificate of mandatory military service. (Include a Japanese or an English translation.) 一身上の都合のため Due to personal reasons 具体的な理由 Give details: 休学期間 年 月 年 月 \Box から Month Period of Absence Year Day Year Month *奨学金・奨学融資制度を受けている者は、この届を提出する前に必ず奨学金担当窓口で手続をしてください。 Note: Those currently receiving scholarships or financial aid must visit the Scholarships and Financial Assistance Group on their campus before

submitting this application.

受けている(名称

利用したことがある

Have used it before

Currently receiving (Name of scholarship(s):

金

学

Scholarships 奨学融資制度

Deferred Loan System

慶應義塾大学長殿

To the President of Keio University

注意

1. 2. 3.

就

確		添付書類	有()•無	減免	有・無 教授会承認日 (研究科委員会)				年	月	月	
認			予定データ入力				入力データ作成				備考			
欄	月日	取扱年月日	年	月	日		年	月	目	Ħ				